

证券代码：300136

证券简称：信维通信

深圳市信维通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	2026年3月25日 国泰海通证券组织走进上市公司交流活动，投资者包括火神私募投资、菁英时代投资、量见投资、熙宁投资、加乘资本、沐德资产、逆为投资、以撒投资、四创资本、圆石投资等。 以上排名不分先后。
时间	2026年3月25日
地点	深圳市宝安区沙井街道西环路1013号信维通信工厂 会议室
上市公司接待人员	董事会秘书：卢信 证券事务代表：伍柯瑾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题：公司定增募投方向及布局逻辑？</p> <p>公司本次定增募资不超60亿元，全部投向三大项目：1. 商业卫星通信器件及组件：总投资35.63亿元，募资28.5亿元；2. 射频器件及组件：总投资28.53亿元，募资21.5亿元；3. 芯片导热散热器件及组件：总投资11.7亿元，募资10亿元。布局紧扣商业卫星、算力芯片、智能终端通信等产业趋势，强化材料—零件—模组全产业链，突破产能瓶颈，加快打造第二增长曲线。</p> <p>问题：公司商业卫星通信业务客户与业务进展情况？</p> <p>公司自2021年起服务北美卫星客户，是其地面终端主要零部件</p>

供应商，同时也拓展了第二家北美卫星客户，产品已批量交付。此外，公司本次定增项目聚焦商业卫星地面终端的高频高速连接器、阵列天线及整机等方向，未来随着卫星星座建设加速，业务规模有望持续提升。

问题：公司芯片散热业务技术、客户及定增扩产规划？

公司在芯片封装散热方面有一站式解决方案，聚焦高导热热界面 TIM1 材料与芯片封装散热片两大核心产品。在 TIM1 材料方面，公司通过自研掌握了基于液态金属和高分子材料的先进配方技术，该材料具备高热导率、优异的界面兼容性与极端工况适应性，能够精准匹配先进封装及算力芯片等高端应用场景的散热需求。在芯片封装散热片方面，公司掌握了核心的精密微加工与半导体表面处理技术，在保障性能与品质前提下兼具产能与成本优势，满足多场景下的可靠性要求。公司已为北美头部消费电子客户批量供应芯片级导热散热材料及器件。本次定增向上游材料延伸，打造“TIM 材料+导热散热器件”一体化方案，面向算力芯片、服务器、笔电等场景，提升产品附加值与竞争力。

问题：公司射频主业技术储备与客户优势？

公司为全球泛射频龙头，具备 LCP 薄膜、柔性覆铜板自主量产能力，供应北美消费电子客户，天线模组全球市占率领先。布局各类天线射频器件，通过了消费级、工业级、汽车级多场景质量体系认证，技术可适配 6G、卫星通信、智能汽车场景，持续推进研发与客户验证。

问题：公司汽车射频业务进展与客户覆盖情况？

公司将消费电子射频技术延伸至汽车领域，供应车载天线、毫米波雷达模组等射频器件，已进入国内头部车企供应链。汽车电子业务收入快速增长，成为重要增量板块，后续将持续拓展全球车企客户。

	<p>问题：MLCC 业务当前验证、客户推广进度及该子公司未来规划？</p> <p>信维电科已实现关键料号突破与国产替代，部分产品在北美大客户验证中，性能对标国际龙头。公司稳步拓展消费电子、汽车电子等下游场景，推进规模化量产与客户导入。未来也不排除进一步增加信维电科的股权，并将按照信息披露要求对后续进展及时履行信息披露义务。</p> <p>问题：公司定增项目建设周期、投产节奏与业绩贡献预期？</p> <p>公司定增项目整体建设期为 36 个月，采用分批投产模式，建设期内即有产能投入生产、产生效益。公司已与核心客户建立深度合作，产能将匹配订单需求，随着项目逐步落地，卫星通信、芯片导热散热、高端射频将成为新增长极。</p> <p>问题：本次定增对公司未来发展带来的影响？</p> <p>公司本次定增以泛射频为根基，商业卫星通信、智能终端天线、芯片导热散热为三大增长引擎。依托技术壁垒与头部客户资源，把握卫星通信、算力芯片、智能终端等产业发展趋势，优化产品结构，提升盈利水平，实现高质量可持续增长。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2026-3-25